

证券代码: 688525 证券简称: 佰维存储 公告编号: 2024-031

## 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于与惠普签订商标许可补充协议的 自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、概述  
深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)自2016年11月获得惠普有限公司(以下简称“惠普”)全球独家授权,许可公司使用惠普(HP)商标,许可在出厂的SSD产品(含后装市场内置SSD产品及外部便携式SSD产品)、后装市场SDRAM产品及后装市场存储卡产品上使用惠普商标;许可期限至2024年12月31日;授权方式为惠普仅提供品牌授权,由被授权方独立负责产品的研发、设计、生产和销售。  
自公司获得惠普全球独家授权以来,公司的相关产品在产品质量、技术水平、销售渠道、售后服务等方面均表现优异,在市场上积累了良好的口碑,公司与惠普的授权产品业务规模逐渐加大,业务合作日益加深,发展态势较好,合作并无中断,且公司已与惠普完成过一次关于许可期限的谈判。

二、交易对方的基本情况  
企业名称:惠普有限公司(HP, Inc.)  
股票代码:HPQ.N  
成立日期:1939年  
办事处地址:1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304  
法定代表人:Charles V. Bergh  
经营范围:计算机硬件及其相关产品的研发和生产和服务。  
与本公司是否存在关联关系:不存在  
惠普有限公司是面向个人用户、大中型企业和研究机构的全球技术解决方案提供商,其提供的产品涵盖信息技术基础设施、个人计算与接入设备、全球服务的图像与平板电脑等。  
惠普有限公司是美国纽约证券交易所上市公司,关于惠普有限公司相关财务数据请关注其发布的公告。

三、以数据来源于公开查询。  
三、补充协议的主要内容  
(一) 调整原许可协议的有效性  
原协议许可期限至2024年12月31日,现延长至2025年12月31日。  
(二) 调整许可权费率  
1、SSD产品许可费率下调,自2024年4月1日起生效。  
2、SDRAM产品许可费率下调,自2024年4月1日起生效。  
3、存储卡产品许可费率下调,自2024年4月1日起生效。  
4、下调最低年度特许权使用费和最低季度特许权使用费。  
(三) 延长部分区域的商标许可  
本次延长许可的部分区域为中国、印度、墨西哥、智利、秘鲁。原许可区域为全球79个国家或地区。

四、对公司的影响  
(一) 对公司业绩的影响  
2023年惠普许可产品全部地区营业收入约占公司营业收入的10.31%,本次延长许可的部分区域营业收入约占公司营业收入的5.59%。2024年,补充协议仅对公司带来费率下调的影响,对公司经营业绩无重大影响。  
五、审批程序  
2024年4月29日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司与惠普签订商标许可补充协议的议案》,同意公司与惠普继续维持并延长部分区域的商标许可。本事项无需提交股东大会审议。  
六、重大风险提示  
(一) 部分条款在原协议约定的许可期限到期后可能不再续期,对公司未来的经营业绩可能存在一定影响。  
(二) 公司惠普支付的最低许可权可在相关产品销售收入未达到预期仍按照下限值向惠普支付许可权使用费的风险。  
(三) 上述拟签署的补充协议许可期限到期后,存在部分或全部无法续期的可能,若无法部分或全部续期则将对公司营业收入造成一定不利影响。  
(四) 公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,及时履行相应的决策和披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。  
七、相关应对措施  
公司与惠普建立了密切的合作关系,并将就授权事项的续期进行持续沟通。此外,公司拥有包括自有C端品牌在内的完整的品牌矩阵,将不断加强品牌推广及销售力度,巩固市场份额。  
特此公告。  
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码: 688525 证券简称: 佰维存储 公告编号: 2024-036

## 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司2023年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)》(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的相关规定,公司就本次发行对普通股股东权益摊薄即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容如下:

一、本次发行的影响分析  
(一) 测算假设及前提  
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。  
以假设仅以测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。  
1. 假设本次发行预计于2024年12月底完成,该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以证监会注册并实际发行完成时间为准。  
2. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等没有发生重大变化。  
3. 假设本次募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元(含本数),暂不考虑发行费用等影响。假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的15%,即不超过64,549,370股(含本数)。在测算公司总股本时,以本次发行股数为基础,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑转债、回购注销、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。  
4. 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-62,435.89万元,扣非后归属于上市公司股东的净利润为-64,175.78万元。  
5. 根据公司最近三年经营情况及谨慎性原则,假设公司2024年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按照以下业绩增幅分别测算:(1)实现盈亏平衡;(2)实现盈利且盈利规模为2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润的50%;(3)亏损且亏损规模为2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润的50%。该假设仅用于分析本次发行对特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。

二、对公司主要财务指标的影响  
基于上述假设,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2023年度(2023年12月31日)		2024年度(2024年12月31日)	
	2023年度	2023年12月31日	本次发行前	本次发行后
假设1:2024年度实现盈利,且2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润增加50%	43,032.91	43,032.91	43,032.91	49,887.85
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,175.78	0	32,087.89	32,087.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.49	0.75	0.75	0.75
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.49	0.74	0.74	0.74

假设2:2024年度实现盈亏平衡

扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,175.78	0	0	0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.49	0	0	0
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.49	0	0	0

假设3:2024年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润为2023年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润的50%

扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-64,175.78	-32,087.89	-32,087.89	-32,087.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-1.49	-0.75	-0.75	-0.75
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-1.49	-0.75	-0.75	-0.75

注:基本每股收益和稀释每股收益的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。  
三、本次发行摊薄即期回报的风险提示  
本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期,在公司股本和净资产均增加的情况下,如果公司业绩暂未获得相应幅度的增长,本次向特定对象发行完成后公司的即期回报(每股收益等财务指标)将存在被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄或发生变化的可能性。  
特别提醒投资者理性投资,关注本次发行对特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性  
(一)惠州佰维先进封装及存储器制造基地扩产建设项目  
1. 项目概况  
本项目投资总额 88,947.41 万元,拟投入募集资金 88,000.00 万元,实施地点位于广东省惠州市,为公司全资子公司惠州佰维现有厂区。项目募集资金主要用于洁净室装修、购置生产设备等,以提高公司生产能力和生产效率,满足公司业务扩张的需求,助力公司实现进一步发展。

2、项目实施的必要性和可行性分析  
(1)响应国家政策号召、推动国产化发展,推进新一轮信息化进程  
随着信息技术的不断发展,信息的传递和存储在社会发展中变得至关重要。存储器作为物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的信息存储核心,承载了经济、社会、科技等信息和资源,对国家发展起到至关重要的作用。因此存储芯片的国产化发展对我国新一轮信息化进程具有十分重要的战略意义。  
集成电路行业作为现代信息技术产业的硬件基础,是促进经济发展的先导性、基础性、战略性新兴产业。为支持集成电路产业关键核心技术突破,政府出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(国家集成电路产业发展推进纲要)《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》等多项鼓励性政策,从财税、技术、人才、应用、国际合作等多方面予以优惠,持续提升我国集成电路产业发展。

2021年3月,全国人民代表大会审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,进一步明确了集成电路领域技术攻关和创新发展在“十四五”期间的关键作用。我国集成电路产业的政策红利显示出了良好的延续性,有利于推动我国集成电路行业的健康发展,为募投项目顺利实施提供了可靠的政策保障。  
当前我国正处在高质量发展进程中,产业转型升级在加速,存储芯片在推动国家信息化上承担着关键作用。因此,公司积极响应国家产业政策号召,拟通过本项目实施,持续引进优秀人才,提升工艺制造水平,扩大制造产能,助力本土产业链的发展壮大。  
(2)顺应行业周期性、成长性发展趋势,把握市场机遇  
存储行业作为半导体产业风向标,受供需关系影响呈现较强的周期性。近年来,受全球贸易关系持续紧张、国际局部地区政治冲突升级、通货膨胀率高企等因素影响,全球经济不确定性增加,消费市场增长乏力,市场需求疲软,景气度持续低迷,半导体产业链近期受到巨大冲击,行业景气度趋于周期性底部区域。另一方面,未来随着 5G、AI、物联网、云计算等新兴技术的快速发展,5G 智能手机、可穿戴设备、服务器、车载电子、工业物联网等相关终端应用产品将为存储设备带来可观的新增市场需求,长期来看,存储行业整体仍将呈现增长态势,具备长期成长性。根据 WSTS 数据显示,2020-2023 年,全球存储芯片市场规模分别为 1,175 亿、1,538 亿、1,298 亿和 896 亿美元。WSTS 预测,存储市场将在 2024 年迎来大幅反弹,2024 年存储市场规模约为 1,298 亿美元,同比预计增长超过 40%。从中长期来看,根据 Yole 数据,2021-2027 年全球存储芯片行业市场规模的复合年增长率为 8%,并有望在 2027 年增长到 2,600 亿美元以上。

因此,为顺应存储行业周期性、成长性发展趋势,把握市场机遇,抢占市场先机,公司亟需进一步加大对存储产品的产能建设投资力度,提高产品供应和服务能力,不断增强公司盈利能力,巩固和提升公司市场地位。  
公司拟通过本次项目建设,引进先进生产设备,并对公司现有工艺流程进行优化提升,实现产品对高良率的需求,以生产出轻薄小巧的高容量存储芯片产品,进而匹配终端消费电子、车载电子、工业物联、服务器等领域的需求。通过本次项目的实施,公司将实现对产能规模进行扩充,进一步提升公司的产量和产品深度,提高公司的业务规模,进而增强公司盈利能力。  
(3)本土化生产需求快速增长,下游优质客户良好稳定的合作关系保障新增产能消化  
当前国产 DRAM 和 NAND Flash 芯片市场份额较低,近年国内各大推进半导体产业国产化进程,为国产存储器提供了广阔的本土化发展空间,与公司国内存储产业链的上下游企业建立了密切的合作关系,随着国内存储产业链的发展壮大,与之配套的相关产能亟需扩增。  
公司主要产品广泛应用于智能手机、电脑、可穿戴设备、机顶盒、教育电子、游戏机、工业设备、安防监控、医疗设备、车载电子等多个领域,与上述领域头部客户建立了良好的合作关系,并在多个细分市场占据重要份额。公司下游优质客户良好稳定的合作关系有利于保障本项目新增产能的消化。  
(4)公司在先进封装技术封装测试领域拥有深厚的技术积累,为本项目实施提供了有力支持  
生产制造能力是存储器厂商的核心竞争力之一。因此,公司通过加大工艺研发投入,引进先进生产检测设备,推行精益生产,整合工艺流程等措施,大力加强信息化、自动化、智能化制造水平,不断提升生产制造能力。公司掌握 16 层叠 Die、30-40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等国内领先的存储芯片先进封装工艺,为 NAND、DRAM 芯片和 SP 封装产品的创新和大规模量产提供支持,使得存储芯片在体积、散热、电磁兼容等、可靠性、存储容量等方面具有较强的市场竞争力。另外,公司通过自主研发存储芯片测试设备,以及多产品的开发、测试、应用循环验证,积累了丰富的高端产品与芯片封装技术,有效保障了多芯产品的交付质量。  
因此,公司在上述领域已有的深厚技术积累将为本项目实施项目的成功实施奠定坚实基础。

三、项目用地、涉及的审批、备案事项  
本项目实施地点位于广东省惠州市,拟使用全资子公司惠州佰维现有厂房,不涉及新增土地用地审批手续。惠州佰维使用的土地已取得不动产权证书(粤(2022)惠州市不动产权第 5078334 号)。  
本项目备案手续已完成(项目代码:2908-441305-04-01-643742),环评批复程序已完成(惠环批(仲)建〔2023〕199号),能评批复程序已完成(惠能节能证(2023)31号)。  
(二)晶圆级先进封装制造项目  
1. 项目概况  
本项目投资总额 129,246.09 万元,拟投入募集资金 102,000.00 万元,公司拟以广东省为实施地点,以控股子公司广东芯成先进半导体技术有限公司(以下简称“芯成先进”)实施本项目。项目募集资金主要用于购置先进生产设备,研发先进生产工艺,构建晶圆级先进封装能力。  
2、项目实施的必要性和可行性分析  
(1)晶圆级先进封装技术是先进存储发展的必然要求  
先进 DRAM 芯片频率极高,带宽极大,传统的 Wire-bonding 工艺面临挑战,晶圆级封装技术可以通过高密度、细间距互连方案提供更多 I/O 接口和更短的互连路径,提升性能和信号质量,降低功耗。  
先进 NAND 控制器芯片是先进 NAND Flash 存储器的核心部件,其 Serdes IO 速率较高,需通过晶圆级先进封装技术,提供高速互连接口,满足数据传输带宽和高的要求。  
目前“存储端”、“功耗端”算力进一步提升和实现低功耗计算生产了严重的制约,业界普遍探索将存储与计算进行整合,以解决上述难题。其中,细粒存储与计算的物理互联是技术发展的一个重要方向,与计算与存储的互联关系经历了从最初的分立 IC 与计算 IC 的 PCB 板级互连,到将存储 IC 与计算 IC 的封装体叠层(DoP,Package on Package),再到存储 IC 与计算 IC 的高密度间距直接封装、存储 IC 与计算 IC 的 3D 垂直封装,以实现更短的连接路径。上述发展历经在工艺难度上经历了从 SMT 到 BGA 封装再到晶圆级封装的过程,晶圆级封装所实现的高密度间距细间距封装,3D 垂直封装是当前实现存储与计算有效整合的领先路径,广泛应用于先进 AP、高性能计算等领域。  
综上,先进 DRAM 存储器、先进 NAND 存储器、存储与计算整合等领域的发展均离不开晶圆级先进封装技术的支持,晶圆级先进封装技术是先进存储发展的必然要求。  
(2)晶圆级先进封装技术市场发展空间较大,是大湾区半导体产业发展的至关重要环节  
随着后摩尔时代的到来,晶圆制程微缩受限,业界广泛认识到晶圆级先进封装技术在推动芯片高密度集成、性能提升、体积微型化和成本下降等方面的巨大威力,先进封装技术正成为集成电路产业发展的新引擎。随着芯片设计与封装、扇入/扇出型封装、2.5D 封装、3D 封装等先进封装技术的发展以及国内产业链不断壮大,先进封装市场规模迅速扩大。  
根据 Yole 预测,全球先进封装市场有望在 2027 年达到 650 亿美元,预计 2021-2027 年间年化复合增长率 9.6%,与传统封装相比,先进封装的投入并不正成比例,预计到 2026 年先进封装将占到整个封装市场规模的 50%以上。从中长期来看,先进封装技术将持续推动产业的升级和对芯片封装性能的提升而蓬勃发展。

大湾区正在加快建设国内半导体第三极,已经聚集了国内一批领先的终端应用、IC 设计、晶圆制造厂商,亟需在先进封装领域构建链强链。同时,封装技术与芯片设计的终端应用需求联系紧密,在大湾区构建链强链的先进封装企业,能够帮助大湾区发挥其在终端应用方面的比较优势,并实现自身的快速发展。  
(3)通过先进封装技术实现的异构集成是满足广大市场应用需求的关键环节  
由于 5G、物联网和人工智能等新兴行业迅速发展,下游企业对半导体产品集成需求持续提升,驱动先进封装行业蓬勃发展。异构集成可以降低芯片对先进制程的依赖,使每个功能模块选择最适合的工艺节点,通过先进封装技术,将各个功能模块整合为一个系统级芯片,不仅提升整体良率,还降低了芯片的设计制造难度,满足下游应用多样化的要求。  
先进封装技术的发展方向不断向晶圆级封装领域和系统级封装领域发展,公司需不断进行技术创新才能适应市场变化,公司将围绕集成电路下游应用市场集成化、小型化、智能化和定制化的发展趋势,加强构建在先进封装领域的研发、制造、测试能力,提升技术竞争力,扩大市场占有率,以适应行业日益提高的技术要求。  
(4)公司在存储设备项目所需的关键材料,市场竞争力较强  
公司深耕存储器研发设计与封装制造领域,掌握 16 层叠 Die、30-40μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进封装工艺,为 NAND、DRAM 芯片和 SP 封装产品的创新和大规模量产提供支持。

公司与广东省工业大学等共建精密制造技术与装备国家重点实验室实施战略合作,重点围绕高密度互连基板、高密度封装技术、先进封装工艺技术与装备、智能工厂设计运营等领域开展技术攻关,共同推动在大湾区发展晶圆级先进封装技术,并择机落地重大项目。公司已构建完整的、国际化的专业晶圆级先进封装技术、运营团队。项目负责人拥有 15 年以上国际半导体公司运营管理经验,曾主持建立了国内首座 12 英寸晶圆级先进封装工厂并实现稳定量产。项目核心团队具备研发和量产经验,熟练掌握晶圆级先进封装核心技术。  
三、项目用地、涉及的审批、备案事项  
本项目实施地点位于广东省东莞市。项目用地尚待审批。  
本项目备案手续已完成(项目代码:2309-441900-04-01-343504),环评手续已完成(东环建〔2023〕14414号),环评手续已完成(东发改节能证〔2023〕144号)等。此外,东莞市委和政府亦已出具说明,根据《企业投资项目核准和备案管理条例》(政府核准的投资项目目录),本项目不属于需要核准的项目,已履行备案程序,无需履行其他审批,松山湖产业发展局现正履行权限对项目开展审查,已按规定办理程序并出具备案证明,本项目合法、合规、程序履行完毕。  
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的准备情况  
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系  
公司将投入募集资金在扣除相关费用后,将投入惠州佰维先进封装及存储器制造基地扩产建设项目,晶圆级先进封装制造项目。本次募集资金投资项目和公司现有主营业务密切相关,并将满足未来发展的研发投入需求,有助于提升公司核心竞争力。  
本次募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借于他人、委托理财等财务性投资的情况,不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形,并随履行有证明文件。实施,有利于公司进一步扩大业务规模,增强市场竞争力。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的准备情况  
1、公司从事募集资金投资项目在人员方面的准备情况  
公司自设立以来,始终聚焦于半导体存储行业,并培养了一支专业的技术团队。公司核心管理团队中,拥有多位技术专家,能够确保公司在技术和运营上的一流专业水准。同时,公司核心管理团队持有公司股份,形成有效的长期激励机制,保证管理团队和经营团队的高度凝聚力。  
2、公司从事募集资金投资项目在技术方面的准备情况  
公司在半导体存储行业深耕多年,拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,本次实施的募投项目的选择,一方面基于公司充分的市场调研和扎实的产业调研,另一方面基于公司丰富的行业经验和良好的技术储备。截至 2023 年 12 月 31 日,公司共取得 307 项境内外专利,其中发明专利 95 项发明专利,148 项实用新型专利,64 项外观设计专利。  
未来,公司将持续加大技术投入,提升研发管理过程的科学化、标准化和 IT 化。公司将继续巩固和增强解决方案研发能力,并积极投入存储芯片先进封装技术领域,深化产业链布局,提升技术竞争力。公司将通过市场和研发的有效联动,增强产品开发的针对性和竞争力。  
3、公司从事募集资金投资项目在市场方面的准备情况  
公司本次募投项目“惠州佰维先进封装及存储器制造基地扩产建设项目”以公司现有主营业务和核心技术为基础,对公司现有产品平台升级,有利于公司技术创新和产品迭代,扩大销

售规模,增强市场竞争力。公司凭借着优秀的技术实力、服务质量以及严格的品控,与国内外知名企业建立了密切的合作关系。存储设备是信息系统最核心的部件之一,终端厂商对存储器供应商的筛选非常严苛,对产品品质、稳定性及持续供应能力有很高的要求,对供应商所服务的客户群体和经验丰富非常重要。凭借过硬的产品品质、良好的客户口碑和企业声誉,公司产品受到终端厂商的广泛认可。

公司本次募投项目“晶圆级先进封装制造项目”为现有存储芯片先进封装能力的进一步提升,随着先进封装技术的发展和市场需求快速增长,先进封装在整个封装市场的占比正在逐步提升,已广泛用于消费电子、物联网、智能汽车、数据中心等领域,具有广阔市场前景。同时,大湾区半导体产业已具备较强的 IC 设计和晶圆制造能力,终端客户资源丰富,公司通过构建晶圆级先进封装能力将有力地支持大湾区半导体产业链发展,提升区域影响力。  
公司将把握国产化机遇,加强国内客户的覆盖力度,提升服务质量和产品技术竞争力,努力开拓一流客户、一流项目,争取一流业绩。在海外市场,公司将强化团队建设,完善海外生产制造布局,提升供应服务能力,通过本地化团队深耕细作,以优秀的产品竞争力和本地化服务能力,不断提升公司市场份额和影响力。  
综上所述,公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具备良好的基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的准备,确保项目的顺利实施。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施  
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为了保护投资者利益,公司采取以下措施提升公司竞争力,以防范股东回报。  
(一)加强募集资金管理,保证募集资金使用规范  
公司将按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定,公司将积极采取保存储备和监管行为募集资金的重要控制,确保募集资金使用规范,合理防范募集资金使用风险。根据募集资金管理制度规定,本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中,公司将积极推进募集资金投资项目,同时,公司将根据相关法规和募集资金管理制度的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。  
(二)积极稳妥推进募投项目的建设,提升市场份额和盈利能力  
本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策和行业发展趋势。公司本次发行完成及募集资金项目投入后,将有利于巩固及扩大销售规模,有利于提升市场份额、竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位前,公司将积极调配资源,充分做好募投项目开展的筹备工作;募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目的实施,提高资金使用效率,以维护全体股东的长远利益,降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。  
(三)加快公司主营业务的发展,积极实施公司发展战略  
公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及相关法规,与公司主营业务密切相关,符合公司的实际情况和发展需求,有利于公司拓展业务领域,促进公司业务持续快速发展,项目的实施将进一步提升公司的综合竞争力和可持续发展能力。此外,公司建立了完善的战略管理体系,强化战略规划对公司发展的引领作用,同时基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时有效地制定、优化符合公司实际的发展战略,为公司提供明确的发展目标和方向,构建可持续发展的战略领先优势。

(四)持续完善公司治理水平,提升公司经营管理能力和盈利能力  
公司已建立并不断完善法人治理结构,未来将继续严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,持续提升治理结构,确保股东能够充分行使权利,保障董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定履行职责,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。此外,公司已建立了完善的内部控制体系,并将在此基础上积极优化、创造性地提升、优化,提升管理保障能力,完善了财务核算体系,进一步提高经营和管理水平,有效控制经营风险,提升公司整体盈利能力。  
(五)完善利润分配政策,重视投资者回报  
公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2022〕13号)等相关文件及《公司章程》的规定,发行人董事会已审议通过了《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》。未来,发行人将严格执行公司分红政策,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,兼顾全体股东的整体利益以及发行人的可持续发展。  
公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施承诺  
(一)公司控股股东、实际控制人及一致行动人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺  
1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;  
2、承诺自出具日后至本次向特定对象发行股票发行实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且承诺相关承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人/本企业承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;  
3、本人/本企业承诺如违反履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本企业作出此承诺的任何有关填补回报措施承诺,若本人/本企业违反该等承诺且给公司或者投资者造成损失的,本人/本企业愿意依法承担对公司或投资者的赔偿责任。  
4、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人/本企业同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定发布的有关规定、规则,对本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(二)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺  
为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺:  
“1.本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;  
2.本人承诺对个人的职务消费行为进行约束;  
3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;  
4.本人承诺由董事会提名或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
5.若公司未来实施股权激励计划,本人支持股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;  
6.本人承诺自出具日后至本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时,本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺;  
7.本人承诺若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。”

8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或不履行上述承诺,本人将无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”  
特此公告。  
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码: 688525 证券简称: 佰维存储 公告编号: 2024-040

## 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于注销回购股份及减少注册资本 暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
一、通知债权人原因  
深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2024年1月31日审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股票,用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含),回购价格不超过人民币53元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起1个月内。具体内容详见公司2024年2月6日在上交所证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《关于变更回购股份用途并注销回购股份的公告》。  
截至2024年2月6日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份703,464股,实际支付的资金总额为人民币19,997,680.30元(不含印花税、交易佣金等费用)。本次回购金额已达上限,公司已完成本次回购。  
2024年4月29日,公司召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销回购股份的议案》,同意公司变更回购股份用途为“用于注销并相应减少注册资本”,注销全部回购股份共703,464股,并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销后,公司总股本将由430,329,136股变更为429,625,672股,注册资本将由430,329,136元变更为429,625,672元。具体内容详见公司于2024年4月30日在上交所证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销回购股份的公告》。  
二、需债权人知晓的相关信息  
(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系  
公司将投入募集资金在扣除相关费用后,将投入惠州佰维先进封装及存储器制造基地扩产建设项目,晶圆级先进封装制造项目。本次募集资金投资项目和公司现有主营业务密切相关,并将满足未来发展的研发投入需求,有助于提升公司核心竞争力。  
本次募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借于他人、委托理财等财务性投资的情况,不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情形,并随履行有证明文件。实施,有利于公司进一步扩大业务规模,增强市场竞争力。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的准备情况  
1、公司从事募集资金投资项目在人员方面的准备情况  
公司自设立以来,始终聚焦于半导体存储行业,并培养了一支专业的技术团队。公司核心管理团队中,拥有多位技术专家,能够确保公司在技术和运营上的一流专业水准。同时,公司核心管理团队持有公司股份,形成有效的长期激励机制,保证管理团队和经营团队的高度凝聚力。  
2、公司从事募集资金投资项目在技术方面的准备情况  
公司在半导体存储行业深耕多年,拥有深厚的技术积累和丰富的行业经验,本次实施的募投项目的选择,一方面基于公司充分的市场调研和扎实的产业调研,另一方面基于公司丰富的行业经验和良好的技术储备。截至 2023 年 12 月 31 日,公司共取得 307 项境内外专利,其中发明专利 95 项发明专利,148 项实用新型专利,64 项外观设计专利。  
未来,公司将持续加大技术投入,提升研发管理过程的科学化、标准化和 IT 化。公司将继续巩固和增强解决方案研发能力,并积极投入存储芯片先进封装技术领域,深化产业链布局,提升技术竞争力。公司将通过市场和研发的有效联动,增强产品开发的针对性和竞争力。  
3、公司从事募集资金投资项目在市场方面的准备情况  
公司本次募投项目“惠州佰维先进封装及存储器制造基地扩产建设项目”以公司现有主营业务和核心技术为基础,对公司现有产品平台升级,有利于公司技术创新和产品迭代,扩大销

售规模,增强市场竞争力。公司凭借着优秀的技术实力、服务质量以及严格的品控,与国内外知名企业建立了密切的合作关系。存储设备是信息系统最核心的部件之一,终端厂商对存储器供应商的筛选非常严苛,对产品品质、稳定性及持续供应能力有很高的要求,对供应商所服务的客户群体和经验丰富非常重要。凭借过硬的产品品质、良好的客户口碑和企业声誉,公司产品受到终端厂商的广泛认可。  
公司本次募投项目“晶圆级先进封装制造项目”为现有存储芯片先进封装能力的进一步提升,随着先进封装技术的发展和市场需求快速增长,先进封装在整个封装市场的占比正在逐步提升,已广泛用于消费电子、物联网、智能汽车、数据中心等领域,具有广阔市场前景。同时,大湾区半导体产业已具备较强的 IC 设计和晶圆制造能力,终端客户资源丰富,公司通过构建晶圆级先进封装能力将有力地支持大湾区半导体产业链发展,提升区域影响力。  
公司将把握国产化机遇,加强国内客户的覆盖力度,提升服务质量和产品技术竞争力,努力开拓一流客户、一流项目,争取一流业绩。在海外市场,公司将强化团队建设,完善海外生产制造布局,提升供应服务能力,通过本地化团队深耕细作,以优秀的产品竞争力和本地化服务能力,不断提升公司市场份额和影响力。  
综上所述,公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具备良好的基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的准备,确保项目的顺利实施。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施  
本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为了保护投资者利益,公司采取以下措施提升公司竞争力,以防范股东回报。  
(一)加强募集资金管理,保证募集资金使用规范  
公司将按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理制度,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定,公司将积极采取保存储备和监管行为募集资金的重要控制,确保募集资金使用规范,合理防范募集资金使用风险。根据募集资金管理制度规定,本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中,公司将积极推进募集资金投资项目,同时,公司将根据相关法规和募集资金管理制度的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。  
(二)积极稳妥推进募投项目的建设,提升市场份额和盈利能力  
本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策和行业发展趋势。公司本次发行完成及募集资金项目投入后,将有利于巩固及扩大销售规模,有利于提升市场份额、竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位前,公司将积极调配资源,充分做好募投项目开展的筹备工作;募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目的实施,提高资金使用效率,以维护全体股东的长远利益,降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。  
(三)加快公司主营业务的发展,积极实施公司发展战略  
公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策以及相关法规,与公司主营业务密切相关,符合公司的实际情况和发展需求,有利于公司拓展业务领域,促进公司业务持续快速发展,项目的实施将进一步提升公司的综合竞争力和可持续发展能力。此外,公司建立了完善的战略管理体系,强化战略规划对公司发展的引领作用,同时基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时有效地制定、优化符合公司实际的发展战略,为公司提供明确的发展目标和方向,构建可持续发展的战略领先优势。  
(四)持续完善公司治理水平,提升公司经营管理能力和盈利能力  
公司已建立并不断完善法人治理结构,未来将继续严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,持续提升治理结构,确保股东能够充分行使权利,保障董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定履行职责,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。此外,公司已建立了完善的内部控制体系,并将在此基础上积极优化、创造性地提升、优化,提升管理保障能力,完善了财务核算体系,进一步提高经营和管理水平,有效控制经营风险,提升公司整体盈利能力。  
(五)完善利润分配政策,重视投资者回报  
公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2022〕13号)等相关文件及《公司章程》的规定,发行人董事会已审议通过了《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》。未来,发行人将严格执行公司分红政策,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,兼顾全体股东的整体利益以及发行人的可持续发展。  
公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

的,申报日可以收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。  
深圳佰维存储科技股份有限公司  
董事会  
2024年4月30日

证券代码: 688525 证券简称: 佰维存储 公告编号: 2024-029

## 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
重要内容提示:  
● 公司拟将已回购的703,464股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。  
● 公司拟注销回购专用证券账户中703,464股股份,注销完成后公司的总股本将由430,329,136股变更为429,625,672股,注册资本将由430,329,136元变更为429,625,672元。  
2024年4月30日,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,综合考虑公司实际情况,拟将存放于回购专用账户中703,464股股份用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:  
一、回购股份的具体情况  
2024年1月31日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股票,用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含),回购价格不超过人民币53元/股(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起1个月内。  
截至2024年2月6日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份703,464股,实际支付的资金总额为人民币19,997,680.30元(不含印花税、交易佣金等费用)。本次回购金额基本已达上限,公司已完成本次回购。  
二、本次变更回购股份用途的原因及内容  
根据公司实际经营管理情况,结合公司整体战略调整、股权激励激励、库存股情况等综合考虑,公司拟对回购股份用途并注销中存放的已回购股份703,464股用途进行调整,“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并予以注销。  
除上述变更内容外,公司回购股份用途的其他内容不变。注销完成后公司的总股本将由430,329,136股变更为429,625,672股,注册资本将由430,329,136元变更为429,625,672元。  
董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续,并及时披露相关信息。

三、本次变更回购股份用途的合法性、必要性及可行性分析  
1、本次变更回购股份用途并注销符合相关法律法规规定,结合资本市场变化,以及自身实际情况、发展战略和库存股情况等因素考虑,此次变更符合《公司法》(证券法)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。  
四、本次变更对上市公司的影响  
本次变更回购股份用途后,公司将对703,464股已回购股份予以注销并相应减少注册资本,拟注销股份数量占公司当前总股本的0.16%。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东实际权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响到公司的上市地位。  
五、相关履行程序及意见  
(一)履行的决策程序  
本事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,本事项尚需提交股东大会审议。  
(二)监事会意见  
公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,且履行程序合法合规,符合公司的发展战略和经营规划,不会对公司的未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会导致公司股权结构不符合上市条件而影响上市地位。因此,监事会一致同意该议案。  
特此公告。  
深圳佰维存储科技股份有限公司  
董事会  
2024年4月30日

证券代码: 688525 证券简称: 佰维存储 公告编号: 2024-041

## 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》(关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)等议案,具体情况如下:  
一、公司注册资本变更的相关情况  
“综合公司实际情况,拟将存放于回购专用账户中703,464股股份用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于2024年4月30日在上交所证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。  
二、修订《公司章程》的相关情况  
根据《公司法》(证券法)等法律法规的相关规定并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改,具体修改内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币430,029,916元	第六条 公司注册资本为人民币429,625,672元
第十三条 公司股份总数为430,329,136股,全部为普通股	第十三条 公司股份总数为429,625,672股,全部为普通股
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事会成员和其他高级管理人员; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会的报告; (五) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 对公司增加、减少注册资本作出决议; (七) 对发行公司债券作出决议; (八) 对公司合并、分立、解散、清算或变更组织形式等事项作出决议; (九) 对公司重大收购、收购本公司股票作出决议; (十) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十一) 对公司股权激励计划作出决议; (十二) 对公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本作出决议; (	